

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年12月19日(19.12.2024)



(10) 国際公開番号

WO 2024/257539 A1

(51) 国際特許分類:
C09J 9/02 (2006.01) C09J 163/00 (2006.01)
C09J 4/00 (2006.01) C09J 163/02 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2024/017896

(22) 国際出願日: 2024年5月15日(15.05.2024)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2023-098857 2023年6月16日(16.06.2023) JP

(71) 出願人: 株式会社スリーボンド (THREEBOND CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1920398 東京都八王子市南大沢四丁目3番地3 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 森本 康介 (MORIMOTO, Kosuke); 〒1920398 東京都八王子市南大沢四丁目3番地3 株式会社スリーボンド内 Tokyo (JP). 遠藤 悟 (ENDO, Satoru); 〒1920398 東京都八王子市南大沢四丁目3番地3 株式会社スリーボンド内 Tokyo (JP). 根本 崇 (NEMOTO, Takashi); 〒1920398 東京都八王子市南大沢四丁目3番地3 株式会社スリーボンド内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: I B C 一番町弁理士法人 (IBC); 〒1020082 東京都千代田区一番町10番地2 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG,

KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: CONDUCTIVE RESIN ADHESIVE AGENT AND CURED PRODUCT OF SAME

(54) 発明の名称: 導電性樹脂接着剤およびその硬化物

(57) Abstract: Provided is a conductive resin adhesive agent which can be cured in a short period of time and from which a cured product having excellent adhesive strength and excellent conductivity is obtained. This conductive resin adhesive agent contains the following components (A)-(D). Component (A): An epoxy resin having two or more glycidyl groups. Component (B): A polyfunctional vinyl ether having a ring structure (excluding the epoxy resin having two or more glycidyl groups). Component (C): Conductive particles. Component (D): A thermal cationic polymerization initiator.

(57) 要約: 短時間での硬化が可能であり、硬化物の接着力および硬化物の導電性に優れた導電性樹脂接着剤を提供する。下記の(A)~(D)成分を含む、導電性樹脂接着剤、(A)成分: グリシジル基を2以上有するエポキシ樹脂、(B)成分: 環状構造を有する多官能ビニルエーテル(ただし、グリシジル基を2以上有するエポキシ樹脂を除く)、(C)成分: 導電性粒子、(D)成分: 熱カチオン重合開始剤。



WO 2024/257539 A1